

2024年深圳芯片设计及制造展

产品名称	2024年深圳芯片设计及制造展
公司名称	银熊电子信息-专业展会服务
价格	.00/件
规格参数	展会时间:2024.6.26-28 展会地点:深圳国际会展中心（宝安）
公司地址	国际会展中心
联系电话	17674088418 19173144226

产品详情

上届SEMI-e展览面积超40,000m²，集结643家展商，展品涵盖电子元器件、IC设计&芯片、晶圆制造及封装、Mini/Micro-LED、半导体设备、半导体材料、第三代半导体7大领域，同期举办40+主题活动，吸引来自半导体行业、汽车新能源、消费电子、医疗和工控等领域40,757人到场参观交流，累计73,646参观人次。长电科技、华天科技、通富微电、华进半导体、捷捷微电、江波龙、比亚迪、三环集团、时创意、金泰克、敦泰科技、合科泰、沛顿、无锡芯享、英诺赛科、基本半导体、镓未来、天域半导体、烁科晶体、瀚天天成、河北普兴、森国科、镓未来、江苏能华微、聚能创芯、晟光硅研、上海微电子装备、华工激光、凯格精机、新益昌开玖、劲拓/思立康、宇环数控、联得半导体、基恩士、高视、视清科技、猎奇智能、正业科技、埃芯、汉虹精密、纳设智能、思泰克、恩纳基、明治传感器、THK、华卓精科、森美协尔等企业均在本届展会中全面展示了半导体行业的新技术、新产品、新亮点、新趋势，构建起半导体产业交流融合的新生态。

其中，安世半导体、比亚迪半导体、富士康、华为、嘉德新能源、亚科电子、中兴通讯、长安新科等企业组团莅临现场，另有扬杰科技、东微半导体、斯达半导体、中芯国际、英飞凌、中车时代、天科合达、长江存储、华润微、广汽集团、英特尔、微软中国、腾讯、比亚迪、安森美、神龙汽车、小米汽车、一汽丰田、寒武纪、紫光展锐、中芯微、地平线、中科芯（中电第五十八研究所）、兆易创新、华润微电子、华虹、圣邦微、新洁能、集创北方、TCL华星、三安光电、中车时代、天科合达、士兰微、日月光、平头哥、意法半导体、一汽大众、索尼、OPPO、中国电建集团江西电建、天岳先进、时代电气等买家代表均莅临本届展会，零距离探秘科技魅力，助力半导体行业的创新发展。

第六届SEMI-e以【“芯”中有“算”·智享未来】为主题，60,000平方米展出面积，800余家展商，预计观众人数达60,000+。本届展会展示以芯片设计及制造、半导体制造、封测、材料和设备、零部件及检测外，突出AI算力、算法、存储、工业控制、汽车智能化、物联网、AI医疗、教育、智慧能源控制等各种新应用解决方案。